

北京国化新材料技术研究院有限公司文件

关于召开“2026 先进硅基陶瓷技术与应用 交流会”的预通知

各有关单位：

随着全球能源转型与高端装备制造的加速发展，碳化硅（SiC）和氮化硅（Si₃N₄）等硅基陶瓷材料因其耐高温、高硬度、抗腐蚀、宽禁带等卓越性能，成为半导体、新能源、航空航天、精密机械等领域的核心材料。然而，材料制备工艺、成本控制、可靠性提升及跨领域应用仍面临重大挑战。

为促进产学研协同创新，推动硅基陶瓷行业的产业化进程，我院拟于2026年10月27-29日在深圳举办“2026 硅基陶瓷材料及应用技术交流会”，设“高纯硅基陶瓷粉体与先进烧结技术创新”、“SiC/Si₃N₄陶瓷在半导体与新能源装备应用”、“硅基陶瓷3D打印与复合材料高端结构件产业化”三个热门分论坛。报名本会，可免费参加“2026 华南硅业大会及展览会”的配套会议，具体通知如下：

一、组织机构

支持单位：中国石油和化学工业联合会中小企业工作委员会、硅产业绿色发展联盟 SAGSI、中关村光伏产业联盟 ZPVA

主办单位：北京国化新材料技术研究院

承办单位：ACMI 硅基新材料研究所、云南省硅工业工程研究中心

支持媒体：ACMI 硅基新材料、ACMI 光伏新材料、有机硅、气凝胶产业、ACMI@LinkedIn、化工新材料、硅产业绿色发展联盟官网

二、暂定日程

(一) 会议时间：2026 年 10 月 27-29 日

会议酒店：深圳登喜路国际大酒店

酒店地址：深圳市宝安区宝田一路 12 号 (0755-23008888)

(二) 会议议程：

10 月 27 日 参展、有班车	第六届深圳氟硅材料高端应用展览会 2026 深圳国际薄膜与胶带展 时间地点：2026 年 10 月 27-29 日 深圳会展中心
10 月 27 日下午	注册、签到
10 月 28 日上午	大会开幕式
10 月 28 日下午	主题一：高纯硅基陶瓷粉体与先进烧结技术创新
10 月 29 日上午	主题二：SiC/Si ₃ N ₄ 陶瓷在半导体与新能源装备应用
10 月 29 日下午	主题三：硅基陶瓷 3D 打印与复合材料高端结构件产业化
报名本会 免费参加同期 展会、会议	2026 华南硅业大会及展览会： 1、2026 硅橡胶技术创新与应用发展峰会； 2、2026 硅树脂技术创新与应用交流会； 3、2026 纳米二氧化硅材料技术与应用交流会； 4、2026 第四届硅基气凝胶生产及应用高峰论坛

三、收费标准

(1) 参会费用

三人及以上优惠 200 元/人。学生半价。费用含餐饮（中餐和晚餐）及其它杂费。住宿统一安排，费用自理。

日期	9 月 15 日	10 月 15 日	10 月 15 日后
价格	2800 元/人	3000 元/人	3200 元/人

(2) 展位费用

展位类型	价格	备注
展板展位	18000 元/个	1、展板尺寸2.2米（宽）*3米（高）， 配套一张展桌，两把椅子； 2、赠送参会名额2人；

(3) 账户信息

户 名：北京国化新材料技术研究院有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京中航油支行

账 号：0200 2282 0902 0125 456（请注明“硅基陶瓷会议”）

(4) 商务合作

接受赞助发言、手册广告、挂绳、胸卡、易拉宝等各类商务合作。

四、联系方式

何 力 19907121608 heli@acmi.org.cn

钟琦琦 13261313609 zhongqiqi@acmi.org.cn

刘 英 15552665724 liuying@acmi.org.cn

晋靖涛 18736748052 jinjingtao@acmi.org.cn

附件 1：参会回执表

附件 2：分论坛及暂定议题

北京国化新材料技术研究院有限公司

二〇二六年四月三十日



附件 1:

参会回执表

会议名称	2026 先进硅基陶瓷技术与应用交流会			
企业* (发票抬头)				
经营产品	(限添 3 种, 将录入通讯录中)			
通讯地址*				邮 编
参会代表	姓 名	职 务	手 机	电子邮箱
详细信息*				
参会费用	会议简称:	9 月 15 日前	10 月 15 日前	10 月 15 日后及现场
	硅基陶瓷会议	2800 元/人	3000 元/人	3200 元/人
	三人及以上团体再优惠 200 元/人。学生半价。			
	____万____仟____佰____拾____元 ¥: _____元 (含会费、餐饮, 不含住宿, 汇款注明: 硅基陶瓷会议)			
付款方式	户 名: 北京国化新材料技术研究院有限公司 开 户 行: 中国工商银行股份有限公司北京中航油支行 账 号: 0200 2282 0902 0125 456 汇款请注明“硅基陶瓷会议”			
住宿信息*	1、深圳登喜路国际大酒店(准五星), 深圳市宝安区宝田一路 12 号, 0755-23008888, 豪华大床 480 元/天(含早), 豪华双床 500 元/天(含早) 2、深圳嘉禧国际酒店, 深圳宝安宝田一路地铁站点, 距会议酒店 60 米, 单间/标间 350 元/天含早 (签到时间 11 月日, 会议时间 11 月日) 住宿时间: ____月__日至__月__日 共__天, 单间__间, 标间__间, 登喜路 <input type="checkbox"/> 嘉禧 <input type="checkbox"/> 因会议人数较多, 房间有限, 会务组仅为付费代表提前预留房间, 房费请与酒店直接结算; 退房截止日期 11 月 15 日; 未支付会议费的代表, 住宿请自行安排。			
会务组	何 力 19907121608 heli@acmi.org.cn 钟琦琦 13261313609 zhongqiqi@acmi.org.cn 刘 英 15552665724 liuying@acmi.org.cn 晋靖涛 18736748052 jinjingtao@acmi.org.cn			
提示: *为必填项; 参会单位请把报名表 Email 至会务组(以上一人即可), 以便制作通讯录等资料; 发票种类(打√): 电子专票____; 电子普票____。 开票资料:				

附件 2：分论坛及暂定议题

开幕式及主论坛

1、嘉宾致辞

主办方及联合会领导致辞

国际相关行业组织代表致辞

大会主要赞助单位代表致辞

2、主旨报告

院士作前沿技术报告

国家产业主管部门及行业协会专家解读政策

全球龙头企业负责人分享产业实践

著名经济专家分析宏观形势与市场前景

3、嘉宾巡展

领导、院士及与会嘉宾巡视展区

主题一：高纯硅基陶瓷粉体与先进烧结技术创新

高纯超细硅基陶瓷粉体的合成突破与产业化

前驱体法合成硅基陶瓷粉体的新路径

硅基陶瓷粉体的性能精准调控策略

硅基陶瓷粉体规模化生产的痛点破解

SiC 陶瓷常压烧结致密化过程的研究

粉体超微化及烧结助剂引入对碳化硅陶瓷制备的影响

碳化硅陶瓷粉体的新型合成工艺探索

碳化硅陶瓷的 9 大烧结技术

高纯碳化硅粉体合成方法及合成工艺展望

氮化硅粉体燃烧合成制备技术与最新进展

氮化硅陶瓷粉体的高纯、超细制备关键技术

氮化硅陶瓷微粉制备方法与应用研究进展

高纯氮化硅粉体合成：从实验室到量产的技术跨越

连续法硅粉氮化法制备氮化硅陶瓷粉体

燃烧合成法制备氮化硅粉体工艺

氮化硅粉体特性对氮化硅陶瓷基板制备工艺及其性能的影响

常压高温固相反应制备 SiC 陶瓷粉体的研究进展

微波加热技术结合自悬浮碳热还原技术制备高纯纳米碳化硅粉体的方法与流程

主题二：SiC/Si₃N₄陶瓷在半导体与新能源装备应用

高性能碳化硅陶瓷膜制备成套技术与产业化

泡沫陶瓷的制备及应用

弹性陶瓷气凝胶的设计制备及多功能化

超精密全陶瓷轴承研制与应用关键技术

高导热氮化硅陶瓷基板最新进展

半导体封装检测用低变形氮化硅陶瓷超薄片

新一代微波射频窗口用高纯碳化硅

航空发动机燃烧室衬套用耐高温碳化硅

石油化工、核电等领域用超耐磨碳化硅密封环

氮化硅结合碳化硅密具的应用范围及应用

氮化硅轴承及滚动体精密加工技术介绍

Si₃N₄在电动汽车逆变器中的应用

锂电池陶瓷隔膜用 Si₃N₄

Si₃N₄陶瓷在 IGBT 模块中的应用

功率模块封装用高强度高热导率 Si₃N₄陶瓷

功率模块用 AMB 氮化硅陶瓷覆铜基板

碳化硅陶瓷在半导体制程中的前沿应用

碳化硅涂层石墨件的制备及其在半导体装备的应用

基于 SiC 纳米线网络的轻质高强耐损伤的多孔陶瓷

碳化硅陶瓷在半导体设备零部件中的应用与技术创新

主题三：硅基陶瓷 3D 打印与复合材料高端结构件产业化

陶瓷增材制造技术的研究现状与展望

颗粒级配对粘结剂喷射 3D 打印碳化硅陶瓷性能的影响

硅基陶瓷的 3D 打印成型技术与应用

碳化硅粉末床 3D 打印成套技术

碳化硅基陶瓷粘结剂喷射增材制造

先进结构陶瓷柔性制造的发展及应用

陶瓷光固化增材制造技术

基于粉末成形的激光增材制造陶瓷技术研究进展

聚合物前驱体转化陶瓷增材制造技术研究趋势与挑战

基于激光选区烧结增材制造的超轻型碳化硅复合材料光学部件
制造技术

陶瓷材料挤出打印与尺寸精度控制

光固化增材制造技术在熔模铸造中的应用

陶瓷增材制造在生物医学领域的应用研究进展

基于浆料的陶瓷增材制造技术制备多孔陶瓷研究进展

大尺寸碳化硅陶瓷制造技术的发展

超精密全陶瓷轴承研制与应用关键技术

碳纤维增强碳复合材料高温抗氧化硅基陶瓷涂层的研究进展

C/C 复合材料表面耐高温抗氧化硅基陶瓷涂层研究进展

高性能陶瓷刀具先进制造技术与应用

3D 打印专用硅基陶瓷粉体的颗粒设计与适配性研究